

リニアスプリット方式 手動基板分割工具・T-Mシリーズ

電源不要の手動・携帯式卓上分割機。
リニアスプリット方式により、常に安定した切断が可能。

特徴

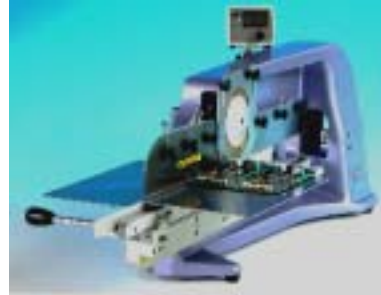
基板全体を直線下刃に固定した状態でスライドさせるので、切断ストレスが進行方向に吸収され、基板に余分な負荷を与えません。

高精度スライド機構により、軽い押力(約1~2kg)でスムーズな分割が可能です。

刃先角度が20度以下なのでV溝の影響を受けることなく、直線的に分割できます。

コネクタなどの部品が切断ラインに重なるように張り出している場合でも、下刃に逃げ加工を施す事により分割が可能です。

卓上型で電源も必要ないため、作業場所を選びません。



T-MS33
(歪みチェッカー
付属モデル)



T-MS20

仕様

項目		機種・型番	T-MD13	T-MS20	T-MS25	T-MS33
対応基板	長さ		120mm	200mm	250mm	330mm
	幅		任意	任意	任意	任意
	厚さ(V溝残厚)		0.4	0.6	0.6	0.8
	種類(材質)		ガラエポ、紙フェノール、コンポジット			
実装部品制限	上面部品高さ		20mm	20mm	35mm	35mm
	下面部品高さ		5mm	7mm	15mm	15mm
分割刃	上刃		ディスクカッター(両刃)			
	下刃	厚	0.7mm	1.0mm	3.0mm	3.0mm
		長さ	130mm	210mm	265mm	350mm
装置外形寸法			300W × 491L × 236H mm	288W × 629L × 273H mm	346W × 890L × 338H mm	406W × 937L × 396H mm

リニアスプリット方式

上下丸刃分割方式は点接触のため、基板の横揺れが発生しやすく、切断面が荒れるという弱点がありますが、基板を線形刃(下刃)に固定した状態のまま円形刃(上刃)方向にスライドさせて分割するリニアスプリット方式においては、この基板の横揺れを防ぐことでカットラインのズレを無くし、基板に与えるストレスを最小限に抑えます。

丸刃を強制的に電動回転させるものと比較し、切粉が少ない点も大きなメリットです。

